

Einführung in die Leiterplatten- und Baugruppentechologie



Von Dipl. Ing. Manfred Hummel, 1. Auflage 2018, 348 Seiten mit 384 Abbildungen und 20 Tabellen.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

72,90 €

Preis inkl. MwSt.

72,90 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Das Buch "Einführung in die Leiterplatten- und Baugruppentechologie" beschreibt in leicht verständlicher Weise alle Verfahren zum Erstellen von Leiterplatten bis hin zur fertigen Baugruppe. Angesprochen werden Entwickler von elektronischen Systemen, Hersteller von Leiterplatten und Bauteilebestücker, Mitarbeiter aus dem Vertrieb, Einkäufer, Studenten und Auszubildende aus technischen Berufen. Der Aufbau beginnt mit dem Leiterplattenlayout und dem Basismaterial. Danach werden alle markanten Leiterplattenarbeitsgänge beschrieben, insbesondere die Änderungen durch Umstellung von bleihaltige auf bleifreie Prozesse.

In einem eigenen Kapitel werden die folgenden Leiterplattenarten erklärt: Ein- und zweiseitige Leiterplatten, Multilayer, starr- und starrflexible Leiterplatten, 3-D MID Leiterplatten, Heatsinkleiterplatten, Hochfrequenzleiterplatten und Keramikleiterplatten. Das Bestücken der Leiterplatte beschreibt die verschiedenen Arten von Bauteilen, deren Bestückungstechniken und alle Möglichkeiten der Löttechnik. Die Baugruppenprüfung und der Schutz der Baugruppe beenden das Konzept. Das Buch vermittelt ein grundlegendes Wissen über die Baugruppe:

Die Hauptkapitel des Buches:

- Leiterplattendesign
- Basismaterial für Leiterplatten
- Technologische Einzelverfahren
- Leiterplattenherstellungsverfahren
- Kontrolle und Reparatur von unbestückten Leiterplatten
- Bauteilebestückung auf Leiterplatten
- Schutz der Baugruppe
- Normen und Richtlinien